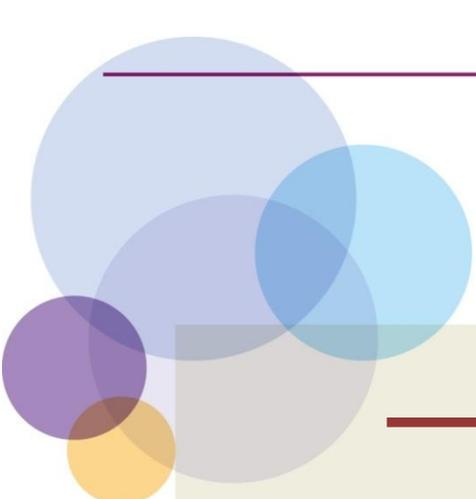


2013年3月期 第2四半期

決算説明会資料

2012年11月7日(水)

ミツミ電機株式会社



2013年3月期 第2四半期 決算概要	P2
---------------------	----

2013年3月期 通期予想	P14
---------------	-----

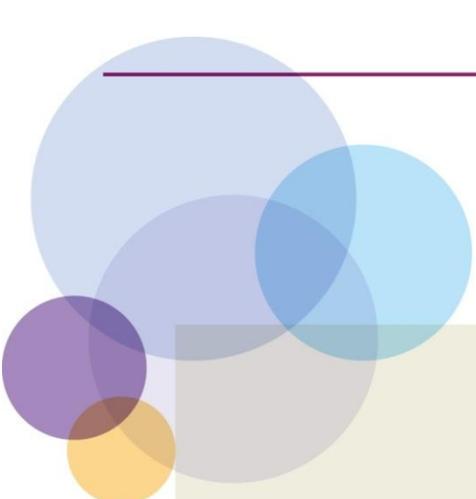
今後の経営戦略・事業の構造改革	P19
-----------------	-----

【免責事項】

この資料は投資家の参考に資するため、ミツミ電機株式会社(以下、弊社)の現状を理解いただくことを目的として作成したものです。

当資料に記載された内容は、2012年11月7日現在において、一般的に認識されている経済・社会等の情勢及び弊社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

投資に関するご決定は、当資料に全面的に依拠することはお控えいただき、皆様ご自身のご判断でなされるようお願い申し上げます。



2013年3月期 第2四半期 決算概要

取締役 本社管理部門担当 兼 経理部統括部長

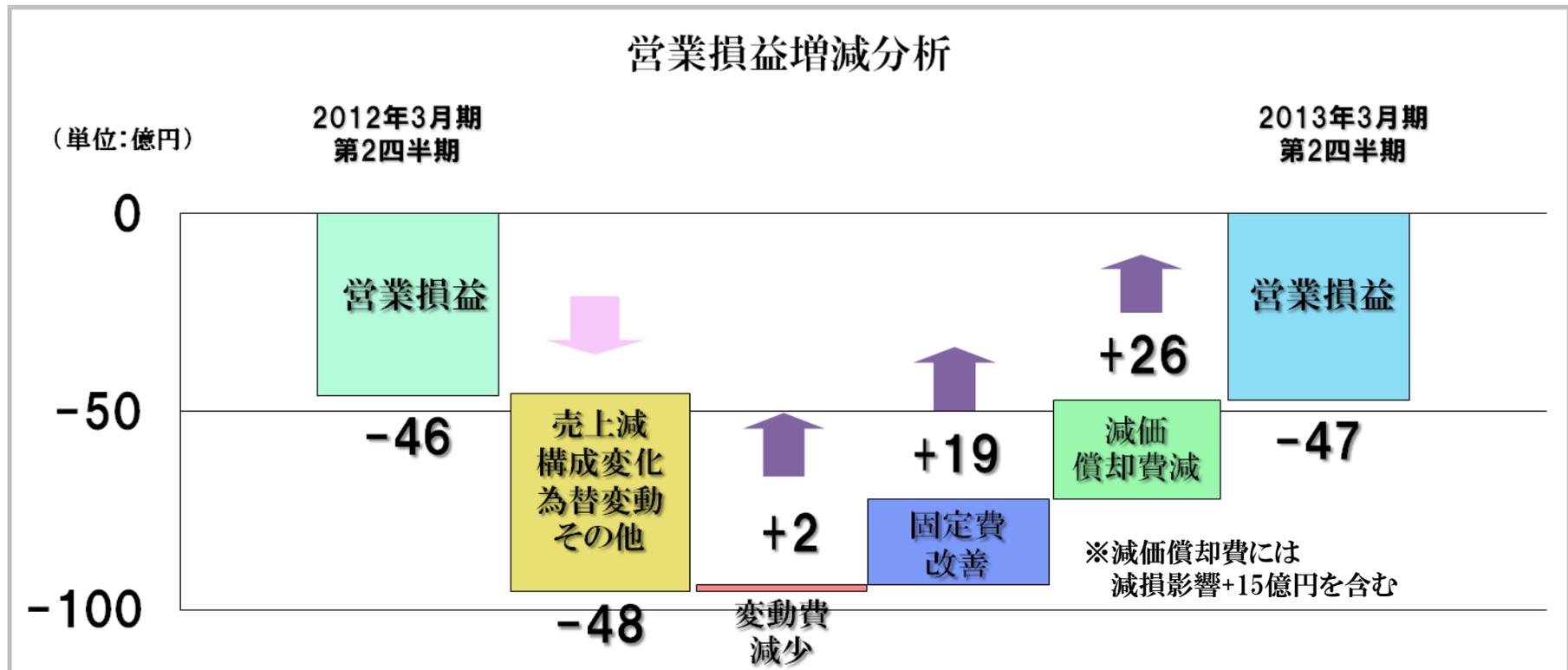
齋藤 求

1. 売上高 : スマートフォンを中心とする情報通信端末・車載関連製品は増加。アミューズメント・薄型TV関連製品は減少。
2. 営業利益 : 売上高の減少、中国の反日デモによる影響
3. 当期純利益: 反日デモによる損失(20億1千2百万円)、半導体事業構造改革費用(9億6千7百万円)・減損損失(2億6千4百万円)を特別損失に計上。繰延税金資産の取崩し(30億1千8百万円)。

	2012年3月期 第2四半期		2013年3月期 第2四半期		対前期比増減	
	金額(百万円)	売上高比(%)	金額(百万円)	売上高比(%)	金額(百万円)	%
売上高	81,124	100.0	68,287	100.0	△12,837	△15.8
営業利益	△4,627	△5.7	△4,745	△6.9	△118	-
経常利益	△5,353	△6.6	△5,433	△8.0	△80	-
当期純利益	△5,599	△6.9	△11,831	△17.3	△6,232	-
為替レート (対米ドル)	80円24銭		79円73銭		51銭の円高	

1. 前年同期比 △1億円

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| ① 最大要因として、売上減による付加価値減少 | -48億円 |
| ② 売価下落により、変動費改善の効果は少額にとどまった | +2億円 |
| ③ 固定費改善(減価償却費除く)は、中国での上昇を其他拠点の削減で吸収 | +19億円 |
| ④ 減価償却費減少は、前年度減損の影響と設備投資の見直しによる | +26億円 |



9月15日に発生した中国の反日デモによる当社製造子会社の損失を特別損失に計上いたしました。

1. 青島三美電機有限公司(山東省 青島市 当社100%)

(1) 建物・製造設備・たな卸資産などの一部が破壊され焼失しました。なお、人的被害はありません。

① 建物・製造設備等の有形固定資産の除却	382百万円
② たな卸資産の除却	1,266百万円
③ 固定費・復旧に伴う臨時費用	305百万円
	計 1,953百万円

(2) 9月15日より事業活動を停止しましたが、9月25日に被災しなかった建屋で部分稼働を再開、借用工場・他子会社・他社での代替生産により10月9日に復旧いたしました。

2. 珠海三美電機有限公司(広東省 珠海市 当社100%)

(1) 近隣地域で反日デモの一部の暴徒化を受け、被害回避のため非稼働としました。

① デモ拡大回避による操業停止期間中(9/16～18)の固定費	59百万円
---------------------------------	-------

合計 2,012百万円

1. 半導体デバイス事業構造改革の前倒し実施

収益性回復にむけて、経営効率の向上とコスト削減を目的とした事業構造改革を、期初計画に対して6カ月から1年前倒し実施いたします。

- ① 製造に係る全機能を千歳事業所へ集約いたします。
- ② 厚木事業所は、ウエハ製造とその関連部門を千歳事業所に移転し、設計・開発機能及びマーケティング・販売機能に限定いたします。実施は2013年9月を計画しております。
- ③ 山形事業所は、ウエハ検査部門を千歳事業所に移転し、半導体デバイス事業に係る全機能を終息いたします。実施は2013年3月を計画しております。
- ④ 対象人員(11月6日時点で厚木事業所約160名、山形事業所約30名)の異動等については、現在、当社労働組合と協議を継続しております。
- ⑤ この施策に伴う費用として9億6千7百万円を特別損失に計上しております。当下半期及び翌事業年度にも追加費用が発生する計画です。

2. 減損損失の計上

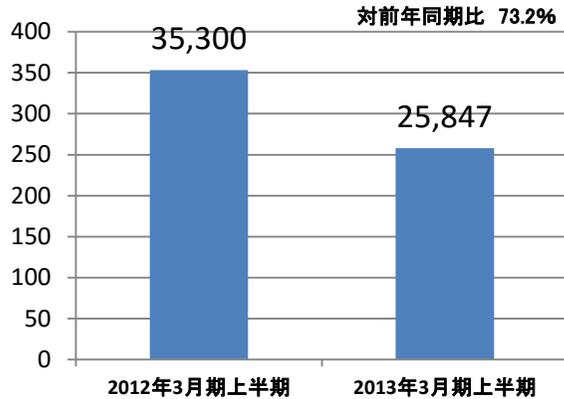
半導体デバイス事業の固定資産2億6千4百万円の減損処理を行いました。当下半期の減価償却費は約6千6百万円の減少を見込んでおります。

1. 売上高 : アミューズメント及び情報端末関連製品の受注の遅延と減少、及び中国反日デモの影響により減少
2. 営業利益 : 売上高の減少、中国反日デモ影響による損失拡大
3. 経常利益 : 為替円高の影響による差損7億3百万円の発生により損失拡大
4. 当期純利益: 特別損失の計上と繰延税金資産の取崩しにより損失拡大

	2013年3月期 第2四半期 予測(5月10日発表)		2013年3月期 第2四半期		予測比
	金額(百万円)	売上高比(%)	金額(百万円)	売上高比(%)	金額(百万円)
売上高	70,000	100.0	68,287	100.0	△1,713
営業利益	△3,000	△4.3	△4,745	△6.9	△1,745
経常利益	△3,000	△4.3	△5,433	△8.0	△2,433
当期純利益	△3,500	△5.0	△11,831	△17.3	△8,331
為替レート (対米ドル)	予測:80円00銭		79円73銭		—

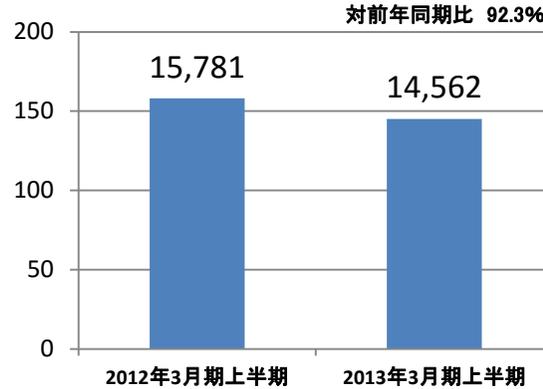
	2012年3月期 第2四半期		2013年3月期 第2四半期		対前年同期比	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	%
半導体デバイス	15,781	19.4	14,562	21.3	△1,219	92.3
光デバイス	5,527	6.8	7,449	10.9	1,922	134.8
機構部品	35,300	43.5	25,847	37.9	△9,453	73.2
高周波部品	14,590	18.0	8,179	12.0	△6,411	56.1
電源部品	8,500	10.5	11,208	16.4	2,708	131.9
情報通信機器	1,423	1.8	1,039	1.5	△384	73.0
売上高合計	81,124	100.0	68,287	100.0	△12,837	84.2

機構部品



情報携帯端末関連は増加。
アミューズメント関連は減少。

半導体デバイス



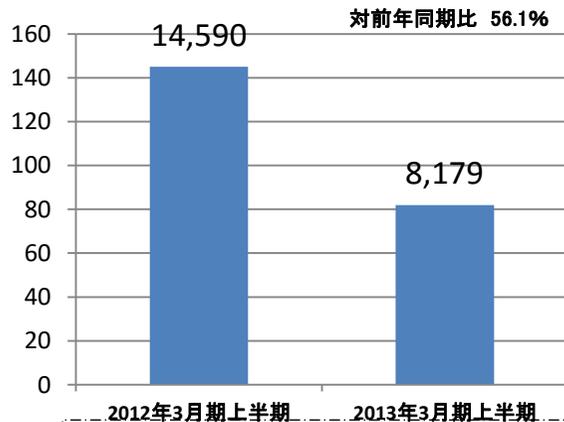
市場低迷でファンドリ受注減少。

電源部品



情報携帯端末関連の増加。

高周波部品



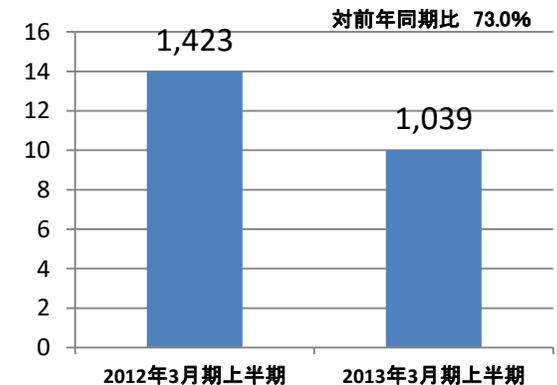
前年地デジ移行特需分の減少。
モジュール製品の減少。

光デバイス



情報携帯端末・車載用カメラ
モジュールの増加。

情報通信機器



不採算製品の継続的撤退。



1. 負債純資産合計の増加： 第3四半期の売上高増加に向け、たな卸資産・買掛金が増加
2. 自己資本比率の低下： 当期純損失計上による株主資本の減少(ネガティブ要因)と負債純資産合計の増加(ポジティブ要因)に起因

(単位:百万円)

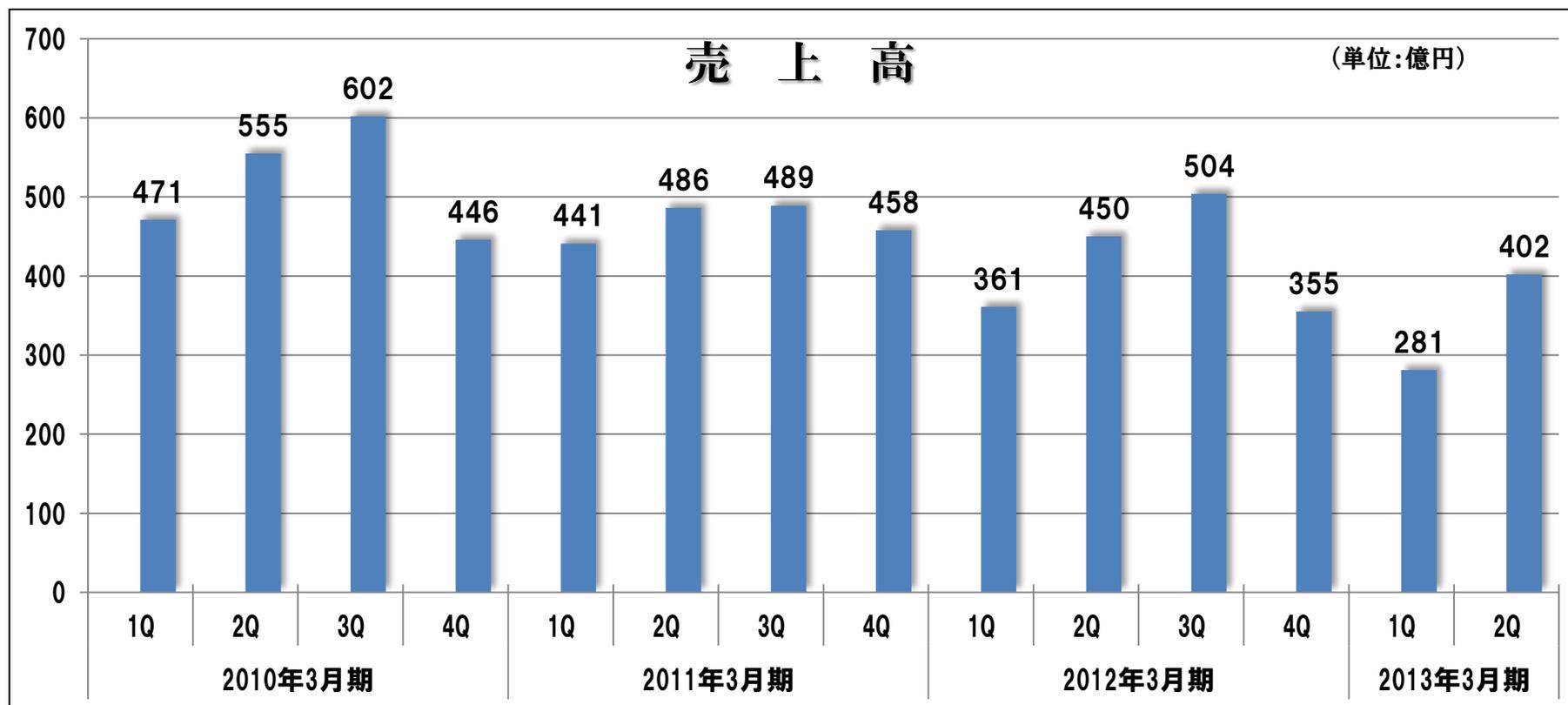
	2012年3月期		2013年3月期 第2四半期		増減金額
	(金額)	(構成比)	(金額)	(構成比)	
資産の部					
流動資産	121,889	79.8	132,209	81.5	10,320
(製品・仕掛品・原材料及び貯蔵品)	(20,735)	(13.6)	(39,547)	(24.4)	(18,811)
固定資産	30,771	20.2	30,022	18.5	△748
資産合計	152,660	100.0	162,232	100.0	9,571
負債の部					
流動負債	41,859	27.4	63,923	39.4	22,063
(支払手形及び買掛金)	(23,532)	(15.4)	(47,075)	(29.0)	(23,543)
固定負債	1,712	1.1	2,343	1.4	630
負債合計	43,572	28.5	66,266	40.8	22,694
純資産の部					
株主資本	125,128	82.0	113,297	69.8	△11,831
その他の包括利益累計額	△16,041	△10.5	△17,332	△10.7	△1,291
純資産合計	109,087	71.5	95,965	59.2	△13,122
負債純資産合計	152,660	100.0	162,232	100.0	9,571
自己資本比率	71.5%	—	59.2%	—	△12.3%

1. 営業活動によるキャッシュ・フロー : 第2四半期の売上高低迷に起因
2. 現金及び現金同等物の期末残高 : 営業活動キャッシュ・フローの悪化、定期預金預入額増加に起因

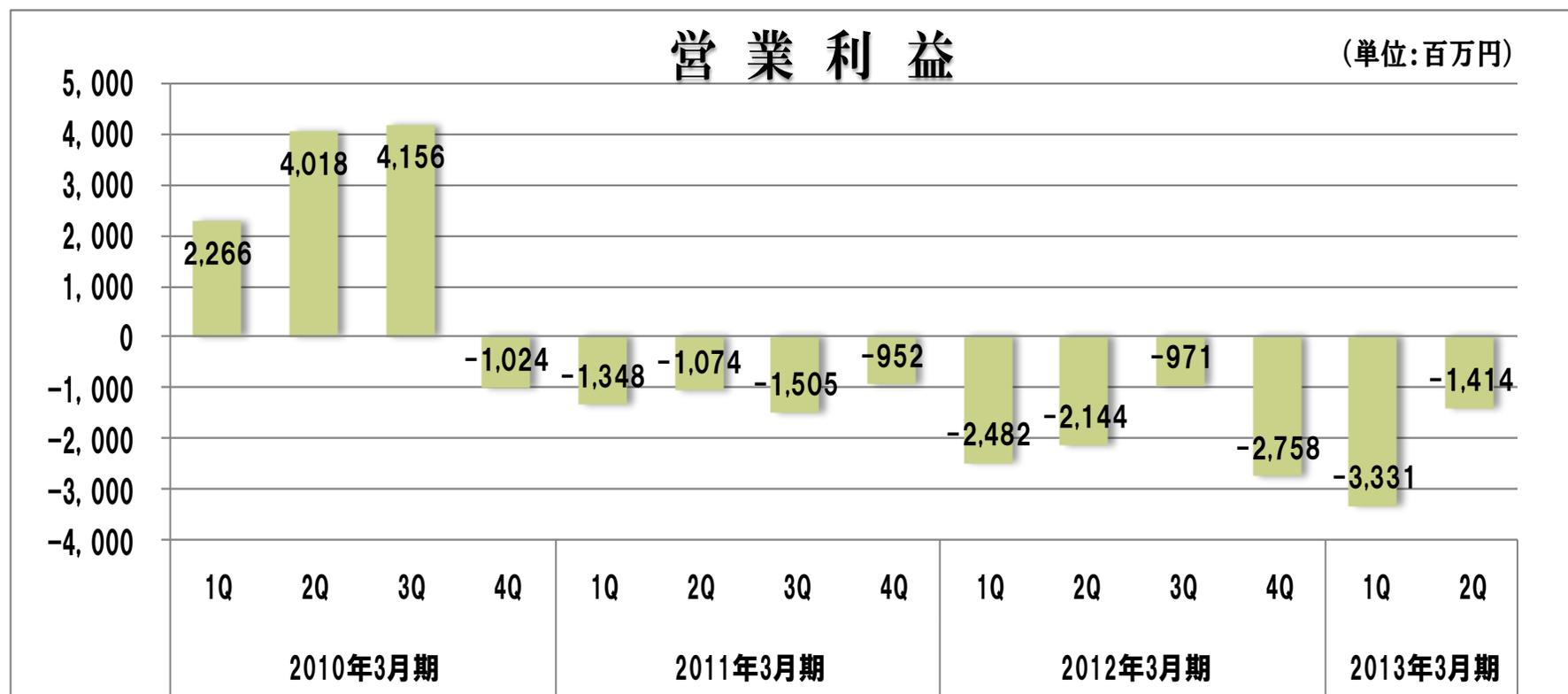
(単位:百万円)

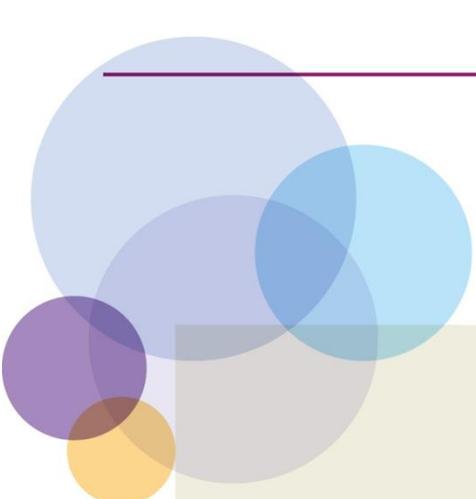
	2012年3月期 第2四半期	2013年3月期 第2四半期	概 要
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,167	△7,701	売上債権:6,117減少 たな卸資産:20,392減少 仕入債務:24,364増加
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,331	△16,181	定期預金預入 による支出:11,114減少
(有形固定資産取得)	(△4,095)	(△5,160)	
フリーキャッシュ・フロー	5,836	△23,882	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,749	△3	
現金及び現金同等物の増減額	3,050	△24,600	
現金及び現金同等物の期末残高	46,467	32,358	
預入期間が3か月を超える定期預金	1,900	12,132	
現金及び預金	48,368	44,491	

1. 円高・新興国企業参入による価格下落の加速、日系大手家電顧客からの受注減少、主力であるアミューズメント関連製品の受注減少を、他製品の拡大で補えていない。
2. セット市場での寡占化、短納期化により、季節変動も一層拡大している。
3. 海外市場で情報携帯端末・車載関連製品の売上拡大により、回復を目指す。



1. 売上高の低迷に伴い、営業利益も低下が続いている。
2. 直近では、情報携帯端末・アミューズメント関連の受注回復が見込まれる。
コスト競争力が高いフィリピン工場を最大限に活用して、営業損益を改善する。





2013年3月期 通期予想

1. 売上高：半導体デバイス・高周波部品が減少、電源部品・光デバイスが増加
2. 営業利益：中国の事業運営コスト上昇を固定費・変動費の削減改善で補う

	2012年3月期 (実績)		2013年3月期 (10月29日発表)		増 減	
	金額(百万円)	売上高比(%)	金額(百万円)	売上高比(%)	金額(百万円)	%
売上高	167,207	100	162,000	100	△5,207	△3.1
営業利益	△8,357	△5.0	△4,500	△2.8	3,857	—
経常利益	△8,234	△4.9	△5,500	△3.4	2,734	—
当期純利益	△28,335	△16.9	△12,500	△7.7	15,835	—
為替レート (対米ドル)	79円06銭		80円00銭 (上半期：79円73銭)		94銭の円安	

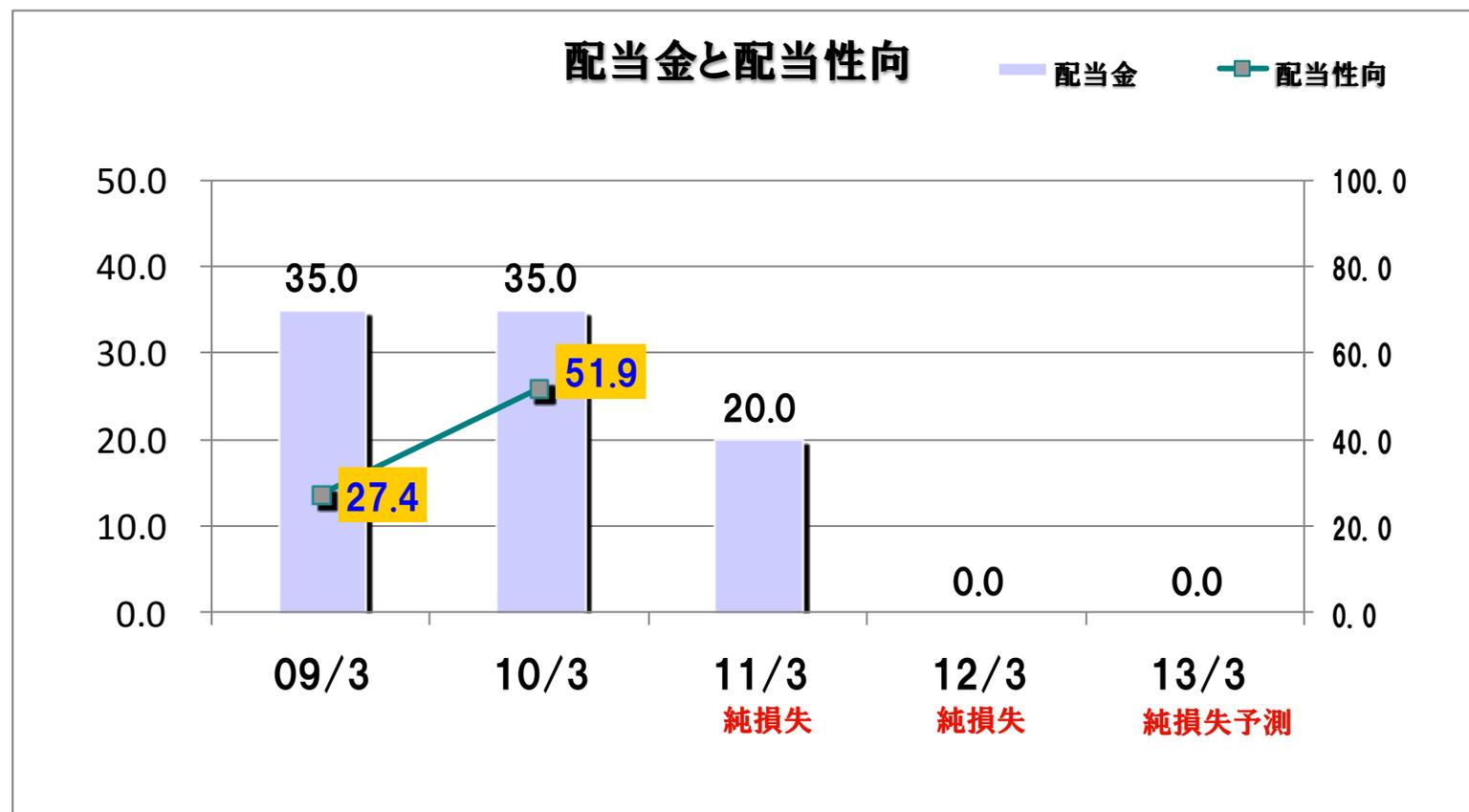
1. 売上高 : アミューズメント・情報携帯端末の受注回復で、対前年同期比+76億円の増加を計画する
2. 営業利益 : 黒字回復を計画する

	2012年3月期下半期 (実績)		2013年3月期下半期 (10月29日発表)		増 減	
	金額(百万円)	売上高比(%)	金額(百万円)	売上高比(%)	金額(百万円)	%
売上高	86,083	100	93,713	100	7,630	8.9
営業利益	△3,730	△4.3	245	0.3	3,975	—
経常利益	△2,881	△3.3	△67	△0.1	2,814	—
当期純利益	△22,736	△26.4	△669	△0.7	22,067	—
為替レート (対米ドル)	79円06銭		80円00銭		94銭の円安	

1. 設備投資・減価償却費 : 受注遅延に合わせて投資タイミングと金額を再設定
2. 研究開発費 : 圧縮と配分見直しにより、重点テーマに集中投資

	2012年3月期 (実績)		2013年3月期 (5月10日発表)		2013年3月期 (11月6日発表)		増減	
	金額(百万円) 下段上半期実績	売上高比(%)	金額(百万円) 下段上半期計画	売上高比(%)	金額(百万円) 下段上半期実績	売上高比(%)	金額(百万円) 下段上半期	%
設備投資	7,954 (4,212)	4.8	10,000 (8,000)	5.6	8,000 (5,235)	4.9	△2,000 (△2,765)	-
減価償却費	10,299 (5,652)	6.2	9,000 (3,800)	5.0	8,000 (2,854)	4.9	△1,000 (△946)	-
研究開発費	12,918 (6,507)	7.7	12,000 (5,300)	6.7	11,000 (5,411)	6.8	△1,000 (111)	-

株主の皆様には誠に申し訳ありませんが、当期は純損失計上の予測に変更したため、無配とさせていただきます予定です。



今後の経営戦略・事業の構造改革

代表取締役社長
森部 茂

電子部品市場のトレンド

エレクトロニクス市場は、一部の上位顧客が市場全体を牽引し、寡占化と拡大が継続します。

新興国競合企業とEMS企業の技術力の向上により日系部品メーカーが優位を保ってきた分野においても価格競争が激化します。

情報通信端末市場は、スマートフォン・タブレットPCの需要拡大とともに新機能部品の搭載が進みます。

車載機器は、コンシューマエレクトロニクス技術との融合が進み、2次電池や通信関連部品の需要が爆発的に拡大します。

目 標

売上高3,000億円を回復する

方 針

1. コア技術の深掘りにより競争優位を高める

地道な研究開発の継続により、新機能製品を最速で市場投入していきます。

2. 総合電子部品メーカーとして事業の相乗効果を高める

部品・モジュール事業を強化します。

内製部品・モジュール部品の活用により、セット事業を拡大します。

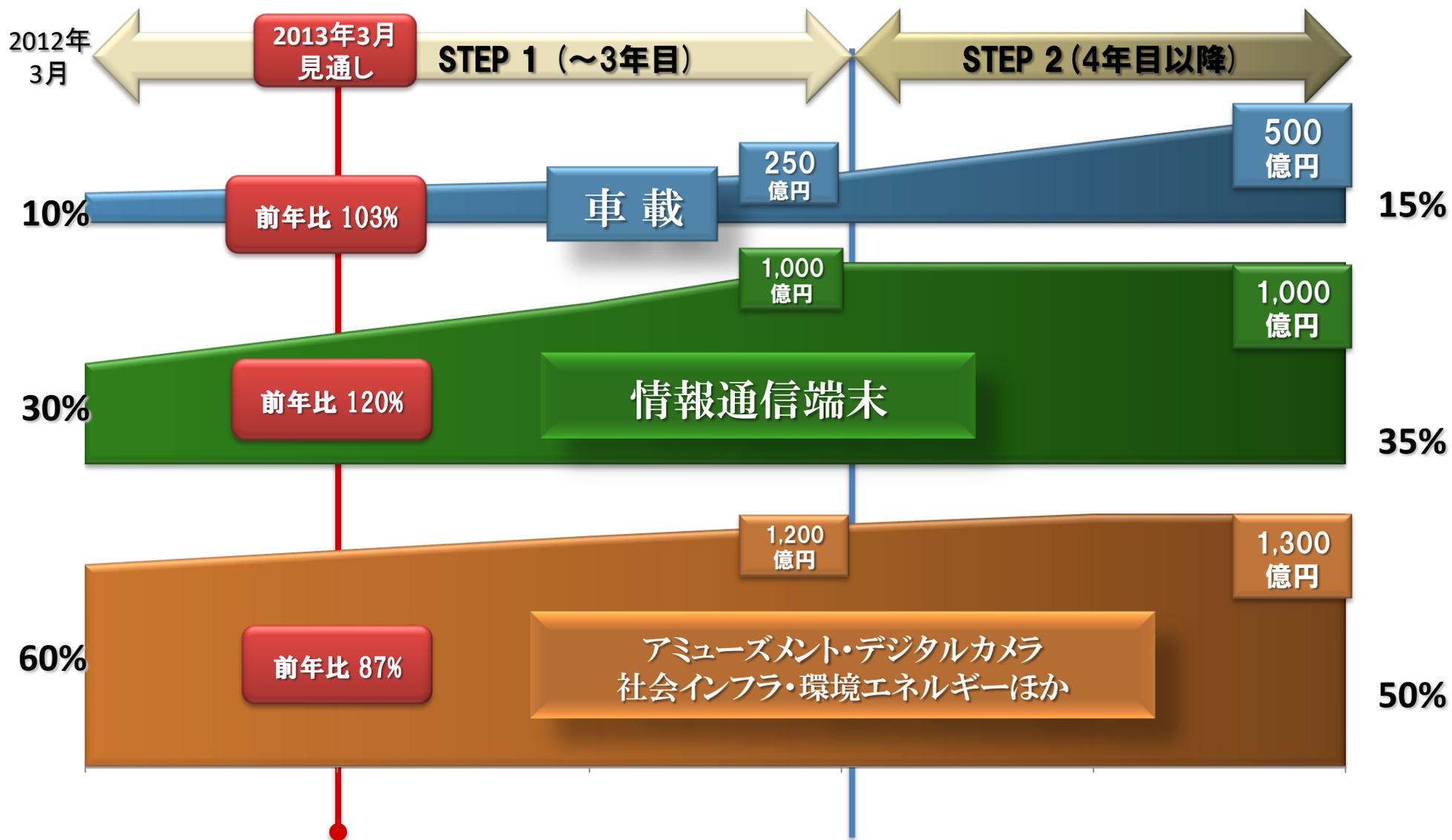
方針

3. 世界の成長企業への売上を拡大する

- ① 海外主要顧客専用技術拠点を設置します。
- ② 海外企業との協業を成長エンジンとします。

4. 市場別売上目標

車載	500億円
情報通信端末	1,000億円
アミューズメント・デジタルカメラ 社会インフラ・環境エネルギーほか	1,300億円



市場別のご説明

1. 車 載
2. 情報通信端末
3. アミューズメント・デジタルカメラ・社会インフラ・環境エネルギーほか

車 載

自動車は、コンシューマエレクトロニクス技術の採用が
今後も更に拡大し、当社の保有技術が活かせる成長分野です。

今期新たに開始する取引を含め5社(グループ)とのTier 1
ビジネスが構築出来ました。

ビジネスの機会が格段に増加しています。

総合電子部品メーカーとしての技術力を活かして
差別化を図った製品を提案して参ります。

車 載

重点製品の展開

1. デジタル放送受信チューナ

北米市場の占有率を現在の20%から50%に高めます。
(2016年)

2. WiFi/Bluetoothモジュール

先行するFord社向けの採用実績を活かし、世界トップシェア
であり続けます。

3. アンテナ (GPS・衛星・AM/FM・WiFi/BT・複合)

Tier1としてのビジネスを更に拡大します。

4. カメラモジュール

スマートカメラで市場占有率10%を目指します。
(2015年)

情報通信端末

重点製品の展開

新機能端末の投入が加速し市場が急成長しているスマートフォンやタブレットPC向けの部品事業を集中的に拡大し、業績回復の柱にします。

1. カメラ用アクチュエータ

上半期で生産能力を倍増させました。更に事業を拡大します。今期本格量産を開始した手ぶれ補正機能(OIS)付きは、先駆者として顧客を増やし市場を牽引します。

2. カメラモジュール

レンズ・センサーメーカーとの協力関係を強化し、高画素領域で事業拡大します。

アミューズメント・デジタルカメラ
社会インフラ・環境エネルギーほか

重点製品の展開

アミューズメントは内製部品の強化、デジタルカメラは新規顧客の開拓により、市場占有率を高めます。

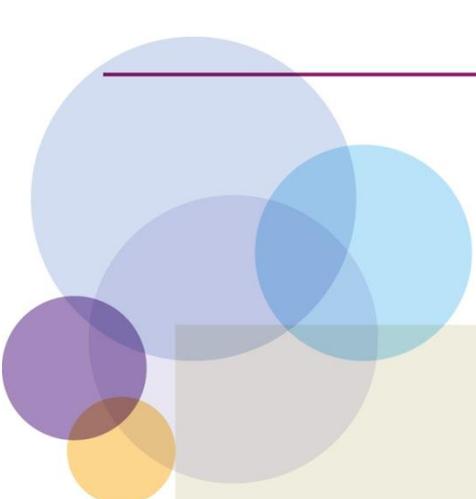
拡大する社会インフラ・環境エネルギーは、IP関連技術や無線技術で市場を開拓して行きます。

1. デジタルカメラ用無線モジュール・充電器

高まるWiFi搭載需要を取り込み、拡大させます。
充電器は海外ODM顧客を含めてシェアを拡大します。

2. IPセットトップボックス

先行する技術資産を活かし事業を拡大します。



事業の構造改革について

1. 半導体事業再編・強化
2. 海外拠点の強化
3. 海外の技術体制

1. 事業領域の絞り込み

電池・電源・センサ分野に注力します。

2. 千歳事業所への集約による事業効率の改善

<目的>

- ① 工場運営の効率化
製造・購買・品質保証・管理を統合
- ② プロセス開発の効率化(千歳事業所への一本化)
- ③ 事業コスト削減

＜集約後の拠点別機能＞

厚木事業所	製品設計・マーケティング販促機能に限定
千歳事業所	生産に関わる一切の機能を集約
セブミツミ	後工程の生産能力を拡大
山形事業所	半導体関連の全機能を終息

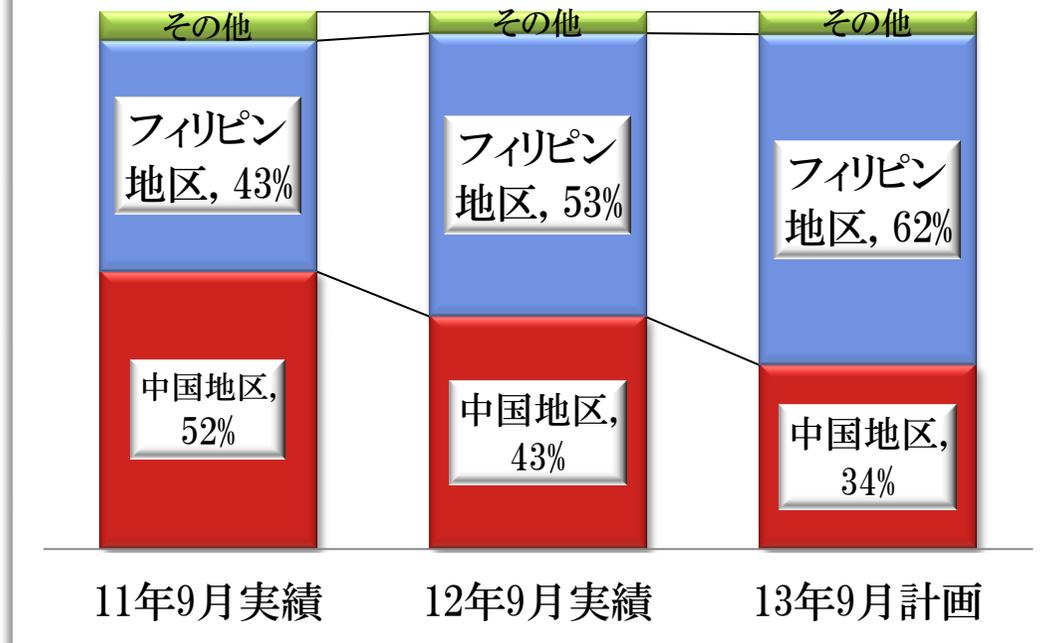
＜スケジュール＞

- ① 山形事業所ウェハ検査工程 2013年3月稼働終了
- ② 厚木事業所前工程 2013年9月生産終了

※異動対象人員は山形事業所約30名、厚木事業所約160名です。
異動条件などは、現在労働組合と協議を行っております。

1. 中国工場は、中国生産が価値を生む製品に特化します。
2. その他の製品は、フィリピンで生産し競争力の強化を図って参ります。
3. 戦略製品を中心に、フィリピン・中国の両地域で自動化を進めます。

海外工場地域別在籍人員比推移



Googleマップより転載しています

車載市場
海外技術体制



Googleマップより転載しています

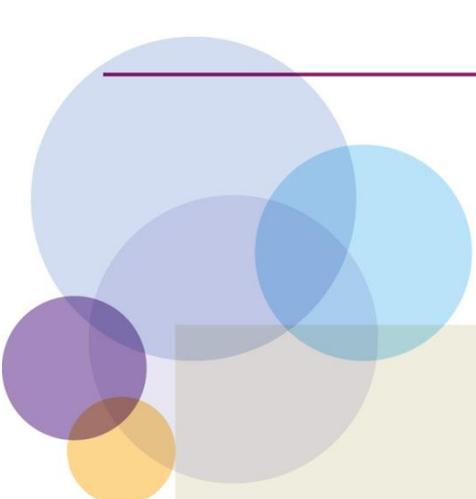
1. 主要顧客の技術・購買・生産拠点の近くで、技術体制を構築します。
2. 米国デトロイトに加え、技術ラボをドイツ・タイでも展開し、顧客への技術支援を充実させます。

情報通信端末市場
海外技術体制



1. 世界で成長する顧客の近くで技術販促体制を構築しています。
2. 現地技術者による製品設計体制を強化し、現地のニーズを取り込んだ製品を開発していきます。

Googleマップより転載しています



IRに関する問い合わせ先

**ミツミ電機株式会社
総務部 広報・IRグループ**

TEL:042-310-5224

FAX:042-310-5168

Mail :prwmaster@mitsumi.co.jp